

Allgemeine Beschreibung

Die pastösen Flussmittel (Tacky Flux) von TAMURA ELSOLD sind für vielfältige Einsatzzwecke in der Elektronikfertigung geeignet. Pastöse Flussmittel vereinen die Vorteile von SMD-Klebern und Flussmitteln. Aufgrund der guten Klebkraft werden Komponenten bis zum Löten in Position gehalten. Die Flussmittel sind wirksam bei bereits vorhandenen Lotdepots; zusätzliches Lot kann aber auch, z.B. in Drahtform, zugeführt werden. Die Flussmittel können durch Dispensen, Sieb- oder Schablonendruck aber auch durch Tauchen oder Bestreichen aufgebracht werden. Die Flussmittel zeichnen sich durch hohe Klebkraft, ausgezeichnetes Benetzungsverhalten, weite Prozessfenster und hohe Kompatibilität mit den meisten Leiterplattenoberflächen aus.

Typische Einsatzzwecke sind:

- Nacharbeit und Touch-up
- Montieren von BGA's und Lotkugeln
- Löten von Flip Chip Komponenten

Flussmitteltypen

Pasten-flussmittel	Flussmittel-typ	Klasse nach J-STD-004	Anwendung
AP-10	No clean	ROL1	Blei- und hochbleihaltige Lote, niedrigschmelzende Legierungen. Gute Aktivität durch geringen Anteil an Halogeniden.
AP-20	No clean	RELO	Hohe Zuverlässigkeit, besonders geeignet für bleifreie Lote Vollständig halogen- und halogenidfrei. Sicherheit (als Pastenflussmittel) geprüft von SIEMENS CT.
AP-40S	No Clean	ROLO	Basierend auf (chemisch aufbereitetem) Kolophonium. Vollständig halogen- und halogenidfrei. Hohe Zuverlässigkeit, gleichermaßen geeignet für bleifreie und bleihaltige Anwendungen auch gemäß ECSS-Q-ST-70-08C

Anwendung

Pastenflussmittel eignen sich bestens für Nacharbeiten. Die Flussmittel können direkt aus der Spritze mittels Dispenser sparsam dosiert werden. Im Schablonen- oder Siebdruckverfahren können mehrere sowie großflächige Depots gleichzeitig mit Flussmittel beschickt werden. Für einfache Anwendungen können pastöse Flussmittel manuell aufgetragen werden.

Pastenflussmittel – Tacky Flux

Reinigung

Die Reinigung der Werkzeuge kann manuell mit Isopropanol oder in automatischen Reinigungsanlagen für Schablonen und die Reinigung von Fehldrucken erfolgen. Flussmittelrückstände können bei Bedarf mit üblichen kommerziell erhältlichen Reinigungsmitteln entfernt werden.

Verpackung

Spritzen: 10 ccm (10 g) und 30 ccm (30 g)

Kartuschen: 6 oz (150 g)

Dosen: 90 g und 180 g

Lagerung und Haltbarkeit

Dosen: 12 Monate im ungeöffneten Gebinde unter dauernder Kühlung zwischen 6 und 16 °C

Kartuschen: Maximal 12 Monate unter dauernder Kühlung zwischen 6 und 16 °C

Lagerung bei Raumtemperatur (16-25°C): Bis mindestens 6 Monate möglich.

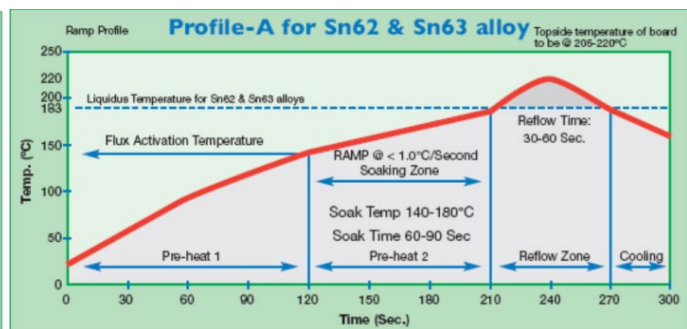
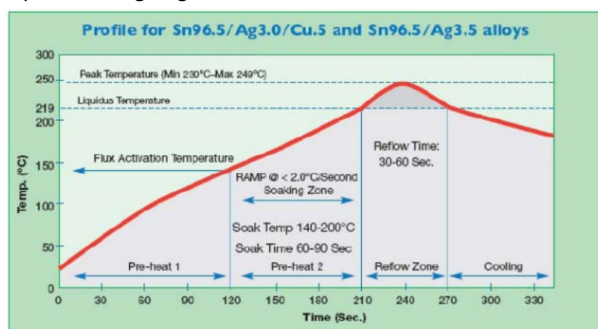
Kurzzeitiger Einfluss von höheren Temperaturen, z.B. auf dem Transportweg:

bis max. 50 °C sind erfahrungsgemäß keine irreversiblen, qualitätsrelevanten Beeinträchtigungen der Paste zu erwarten, darüber hinaus ist eine Beeinflussung der Viskosität möglich. Eine Beeinträchtigung des Lötverhaltens oder der Sicherheit ist in technisch relevanten Temperaturbereichen nicht zu erwarten.

Spritzen und Kartuschen senkrecht mit der Spitze nach unten lagern, Pastenflussmittel niemals einfrieren. Vor dem Öffnen der Gebinde soll das Material Raumtemperatur angenommen haben.

Reflowprofile

Bei der Anwendung von pastösen Flussmitteln eignen sich die unten angegebenen Lötprofile als Ausgangspunkt für die Optimierung eigener Prozesse.



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.